(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 10 mars 2005 (10.03.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/022566 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: H01F 41/00, H03H 7/01, 7/32, H01Q 1/36, 21/00
- (21) Numéro de la demande internationale :
 PCT/FR2004/001873
- (22) Date de dépôt international: 16 juillet 2004 (16.07.2004)
- (25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

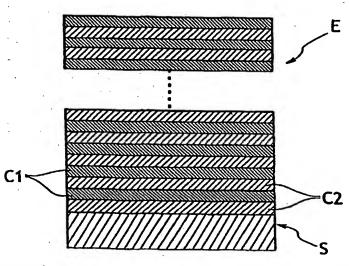
- (30) Données relatives à la priorité : 03/09212 28 juillet 2003 (28.07.2003) FR
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf 11S) : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIEN-TIFIQUE [FR/FR]; 3, rue Michel-Ange, F-75794 Paris Cedex 16 (FR).
- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): BERN-STEIN, Pierre-Ernest [FR/FR]; 2, rue de l'Eglise, F-14480 Villiers-Le-Sec (FR). HAMET, Jean-François,

Maurice [FR/FR]; 15, rue du Parc, F-14610 Anguerny (FR). TOUTTOU, Nabil [FR/FR]; 32, rue de la Plaine, F-38610 Gières (FR).

- (74) Mandataires: PONTET, Bernard etc., Pontet Allano & Associés SELARL, 25, rue Jean Rostand, Parc Club Orsay Université, F-91893 Orsay Cedex (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: METHOD AND SYSTEM FOR THE PRODUCTION OF SUPERCONDUCTING INDUCTIVE COMPONENTS COMPRISING THIN LAYERS, AND DEVICES CONTAINING SUCH COMPONENTS
- (54) Titre: « PROCEDE ET SYSTEME DE REALISATION DE COMPOSANTS INDUCTIFS SUPRACONDUCTEURS EN COUCHES MINCES, ET DISPOSITIFS INCLUANT DE TELS COMPOSANTS



(57) Abstract: The invention relates to a method of producing a superconducting inductive component in the form of one or more line segments comprising a stack of alternate superconducting and insulating films. The invention also relates to the system which is used to implement said method, comprising: means for depositing a superconducting film, means for depositing a stack of alternate superconducting and insulating films, and means for etching all of the deposited films, said means being arranged such that the latter only occurs at the locations where an inductive component is to be implanted.

(57) Abrégé: Procédé pour réaliser un composant inductif supraconducteur, sous la forme d'un ou plusieurs segments de ligne constitués d'un empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants. Système pour la mise en oeuvre de ce procédé, comprenant: des moyens pour déposer un film

supraconducteur, des moyens pour déposer un empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants, et des moyens pour graver l'ensemble des films déposés, ces moyens étant agencés de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.